公司代码：688183　　公司简称：生益电子

生益电子股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在2024年年度报告全文中详细的描述了存在风险事项，敬请查阅年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来可能面对的风险因素。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2024年度利润分配方案拟定如下：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基础，向登记在册全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本83,182.1175万股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份1,551.8757万股，实际可参与利润分配的股数为81,630.2418万股，以此计算合计拟派发现金红利20,407.5605万元(含税)，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为61.47%。本年度利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，母公司所余未分配利润全部结转至下一次分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	生益电子	688183	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐慧芬	杭海梅
联系地址	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号	广东省东莞市东城区(同沙)科技工业园同振路33号
电话	0769-89281988	0769-89281988
传真	0769-89281998	0769-89281998
电子信箱	bo@sye.com.cn	bo@sye.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、汽车电子板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

2.2 主要经营模式

公司的客户主要聚焦在通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，使产品质量和技术能力不断满足下游客户电子产品的需求与变化。因产品为客户定制，公司生产模式为“按单生产”方式，即公司根据客户合同需求，组织产品研发、生产、检验并交货；销售模式方面，由于PCB规格型号众多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下：

(1)盈利模式

公司主要通过核心技术和不断提升的产能为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，使用最优的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术、产能生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户。

(2)采购模式

公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”和“同类合并采购”的模式，即按照客户订单要求采购原材料。定期复核采购情况，采购价格和数量随市场价格和订单而定。

公司采购原材料时通过SRM(供应商关系管理)系统在线广泛寻源，向供应商询价并对样品进行检验和封样，在对技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格的评价考量后，选择优质供应商资源，安排采购订单，并通过SRM系统实现采购业务全过程的闭环管理，建立了科学、有竞争力的采购供应体系。

公司对合格供应商执行严格的管理要求，并制定了《供应商管理工作程序》，通过SRM系统，实现供应商全生命周期的线上闭环管理。供应链管理部负责制定并维护认可供应商清单，对供应商制定年度审核和全面提升计划，根据供应商的技术、质量、交付、服务、成本等进行多维度的考核并提出提升要求。公司认真培养合格供应商，利用公司技术优势，与合格供应商加强技术合作，提升产品能力，实现供应链的双赢，并与战略供应商达成战略伙伴关系，让供应链具备竞争优势。

(3)生产模式

由于印制电路板为定制化产品，公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织生产，质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求，根据下游客户的应用需求，进行PCB产品研发，为客户提供性能优异的PCB产品并根据客户的产品升级需要做好长期技术储备，并为客户提供最优的可制造方案，与客户建立长期稳定的合作关系。

(4)销售模式

根据公司的技术能力和产品定位，对标各行业的重点客户进行合作。通过对客户类型和PCB市场应用情况的分析，公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售；经销是指通过PCB贸易商向终端客户进行销售。经过多年发展，公司建立了较为完善的全球销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员协同公司各职能部门按照客户需求进行分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务，公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

2.3 所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

印制电路板(Printed Circuit Board，简称“PCB”)，也称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印刷元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。

PCB诞生于20世纪30年代，采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中继传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着电子行业的发展，PCB的应用将越来越广泛。

PCB产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分，具体情况如下：

Ⅰ.按线路图层数进行分类

产品种类	简介
单面板	最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面，所以称为单面板，主要应用于较为早期的电路。
双面板	在绝缘基板两面均有导电图形，由于两面都有导电图形，一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来，此类PCB可以通过金属孔使布线绕到另一面而相互交错，因此可以用到较复杂的电路上。
多层板	有四层或四层以上导电图形的印制电路板，内层是由导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成，外层为铜箔，经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印刷导线引出，多层板上安装元件的孔(即导孔)需经金属化孔处理，使之与夹在绝缘基板中的印刷导线连接。多层板导电图形的制作以感光法为主。层数通常为偶数，并且包含最外侧的两层。

Ⅱ.按产品结构进行分类

产品种类	产品特点	应用领域
刚性板(硬板)	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。	广泛分布于计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子和汽车电子等行业。
挠性板(软板)	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接一体化。	智能手机、笔记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等领域。
刚挠结合板	指在一块印刷电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区，将刚层状的挠性印制电路板底层和刚性印制电路板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求。	先进医疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等。
HDI板	HDI为High Density Interconnect的缩写，即高密度互连技术，是印制电路板技术的一种。 HDI板一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印刷电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接。 相较于传统多层印制板，HDI板可提高板件布线密度，有利于先进封装技术的使用；可使信号输出品质提升；还可以使电子产品在外观上变得更为小巧方便。	主要是高密度需求的消费电子领域，广泛应用于手机、笔记本电脑、汽车电子和其他数码产品等，其中以手机的应用最为广泛。 目前通信产品、网络产品、服务器产品、汽车产品甚至航空航天产品都有用到HDI技术。
封装基板	即IC封装载板，直接用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。	在智能手机、平板电脑等移动通信产品领域，封装基板得到了广泛的应用。如存储用的存储芯片、传感用的微机电系统、射频识别用的射频模块、处理器芯片等器件均要使用封装基板。而高速通信封装基板已广泛应用于数据宽带等领域。

Ⅲ.按产品用途进行分类

产品种类	简介
通信设备板	主要应用于移动通信基站及周边信号传输产品等通信设备上的各类印制电路板。
网络设备板	主要应用于自于网传输、路由器、高端交换机、以太网交换机、接入网等网络传输产品。
计算机/服务器板	主要应用于各式服务器及网络计算机等领域。
汽车电子板	主要应用于汽车安全、中控及高端娱乐系统、电动能源管理系统、自动驾驶传感及毫米波雷达等产品。
消费电子板	主要应用于智能手机及其配套设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的电子产品。
工控设备板	主要应用于嵌入式主板、工业电脑等。
医疗器械板	主要应用在CT、核磁共振仪、超声、呼吸机等。
航空航天板	主要应用于航电系统和机电系统，其中航电系统主要包括飞行控制、飞行管理、座舱显示、导航、数据与语音通信、监视与告警等功能系统；机电系统主要包括电力系统、空气管理系统、燃油系统、液压系统等功能系统。

(2)公司所处的行业地位分析及其变化情况

Ⅰ.公司所处行业地位

印刷电路板的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等。生益电子成立于1985年，长期专注并深耕于印制电路板行业，产品以通讯网络、计算机/服务器、汽车电子等应用领域的印制线路板为主，兼顾了消费电子、工控医疗、航空航天等领域知名企业的重要产品，属于中国印制线路板行业领先企业之一。根据CPCA发布的《第二十三届(2023)中国电子电路行业排行榜》，公司在综合PCB1000强中排名第26位，内资PCB100强中排名第12位；根据Prismark发布的第四季度市场报告，公司在全球PCB40强中排名第35位。

Ⅱ.印制电路板行业产值规模及分布

2024年上半年，全球继续保持高利率，市场担忧经济出现硬着陆；但进入下半年来，随着各大央行开启降息周期，全球经济基本实现了软着陆，印制电路板产业需求也逐步恢复。根据Prismark数据，2024年全球PCB市场产值同比增长5.8%，达735.65亿美元。从中长期来看，随着人工智能发展、消费电子回暖等因素的影响下，进而直接或间接地带动了PCB产业的发展，全球PCB行业在2024年至2029年复合增长率为5.2%，总体保持平稳增长。

根据Prismark预测，未来几年，中国仍将是PCB行业的主要制造中心。2024年国内PCB市场产值达412.13亿美元，同比增长9.0%。预测2024年至2029年总体保持增长，但由于产品结构差异和预期生产转移，复合增长率为4.3%，低于全球增速。Prismark预计2024-2029年各个国家和地区的PCB产值增长情况如下：

单位：亿美元

国家和地区	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2024-2029复合增长率
中国大陆	412.13	438.34	455.63	470.82	490.84	508.04	4.3%
日本	58.40	61.57	65.52	70.08	74.09	78.55	6.1%
美洲	34.93	36.32	37.33	38.25	39.55	40.75	3.1%
欧洲	16.38	16.77	16.97	17.46	18.12	18.63	2.6%
亚洲(除中国大陆、日本)	213.82	232.63	247.24	264.26	282.93	300.63	7.1%
合计	735.65	785.62	822.69	860.87	905.53	946.60	5.2%

数据来源：Prismark

Ⅲ.印制电路板行业产品结构及需求变化

根据Prismark统计，受人工智能服务器需求强劲以及手机、PC和平板电脑市场复苏的推动下，2024年每个PCB产品结构均出现不同程度的复苏，其中18层以上多层板和HDI增长最为强劲，分别为40.2%和18.8%。中长期来看，18层以上多层板、HDI和封装基板将保持相对较高的增长，预测2024年至2029年复合增长率将分别达到15.7%、6.4%和7.4%，高于总体增长率。Prismark的统计及预测情况如下：

单位：亿美元

产品结构	2023	2024E	2024增长率	2029E	2024-2029年复合增长率
单/双面板	77.57	79.47	2.4%	91.49	2.9%
4-6层	154.34	157.36	2.0%	176.61	2.3%
8-16层	93.75	98.37	4.9%	121.92	4.4%
18层以上	17.26	24.21	40.2%	50.20	15.7%
HDI	105.36	125.18	18.8%	170.37	6.4%
封装基板	124.98	126.02	0.8%	179.85	7.4%
软板	121.91	125.04	2.6%	156.17	4.5%
合计	695.17	735.65	5.8%	946.61	5.2%

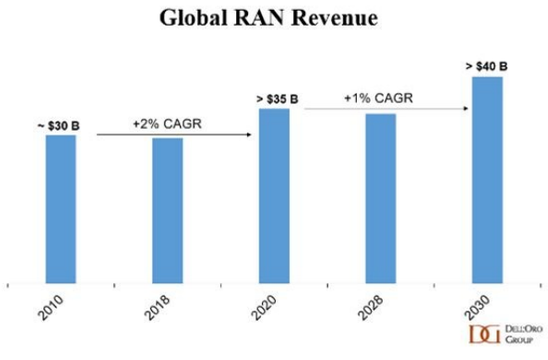
数据来源：Prismark

(3)报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

生益电子以印制电路板为主业，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，同时在已有的高难度复合多种特殊工艺多层板产线外新建成了高精度HDI产线及软硬结合板产线。力求打造行业产品的全面覆盖，提升行业市场占有率，进一步增强公司核心竞争力。

通讯行业

2024年，RAN(无线接入网)市场预计全年下滑5%-8%。北美和亚太地区(不包括中国在内)的增长对全球RAN市场有一定支撑作用，但中国RAN市场在2024年呈现下降，预计2025年不会出现明显改善，因此全球RAN市场在2025年预计或将以低个位数的速度增长。随着数字化转型的加速推进和人工智能产业的快速发展，各行各业对高速网络基础设施的需求加速，网络市场在2024年实现增长。受益于人工智能产业的强势拉动，增长动力有望延续至2025年。

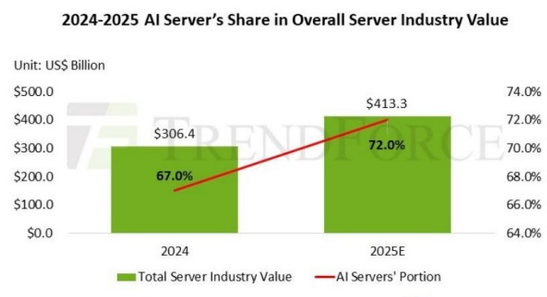


来源：Dell'Oro Group

报告期内，虽然行业增长疲弱，但是公司凭借敏锐市场洞察力合理调整市场策略，推动通讯网络板块稳健发展。生益电子坚守战略定位，聚焦高端研发，积极寻找机会，与头部企业合作，在800G高端交换机等领域取得重大突破。目前相关产品已经完成多家顶尖企业的认可，并陆续批量。同期，公司在卫星通讯领域也取得了积极进展。经过不懈努力，公司卫星通讯相关的系列产品已完成前期研发与测试工作，争取并通过了多家客户的产品认证，该类产品有望在2025年实现批量生产的目标，为公司在该领域的市场拓展奠定坚实基础。

服务器行业

根据TrendForce的报告，预计2024年整个服务器行业的总价值有望达到3,060亿美元。其中，与AI服务器相关的行业价值预估约为2,050亿美元，与标准服务器相关的行业价值相比，其增长态势更为强劲。展望2025年，在需求旺盛的有力推动以及产品平均售价较高等利好因素加持下，预计AI服务器细分市场的价值将攀升至2,980亿美元。此外，预计到2025年，AI服务器将占整个服务器行业总价值的70%以上，成为服务器行业的核心驱动力。



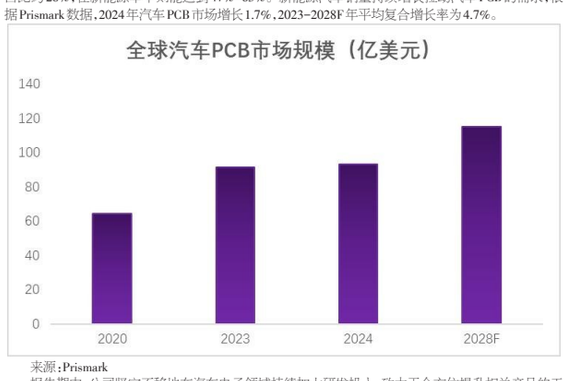
来源：TrendForce

报告期内，为打造更具竞争力的解决方案，公司积极携手多家知名AI服务器企业，展开深度合作。在与行业客户紧密无间的沟通协作过程中，公司精准把握行业痛点，敏锐洞悉发展趋势。凭借在高端产品加工领域积累的深厚经验，公司对服务器产品进行了全方位、多层次的优化升级。

报告期内，公司在AI服务器相关产品项目上成绩斐然，服务器产品在公司销售中的总占比一举跃升至48.96%，相关市场份额也大幅提升，为公司业绩实现大幅增长提供了强劲动力与坚实支撑。展望2025年，鉴于AI产品市场需求呈现出持续迅猛增长的态势，公司仍将积极进取，持续加大技术研发投入，全方位提升技术实力，同时优化产能布局，扩充产能规模，以满足客户对高端产品日益增长的旺盛需求。

汽车电子行业

EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,823.6万辆，同比增长24.4%；中国新能源汽车销量达到1,286.6万辆，同比增长35.5%。预计2025年全球新能源汽车销量将达到2,239.7万辆，其中中国将达到1,649.7万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4,405.0万辆。汽车在电动化、网联化、智能化三大趋势下，汽车电子产品在整车占比中不断提高，汽车电子在传统高级轿车中的价值量占比约28%，在新能源车中则能达到47%-65%。新能源汽车销量持续增长拉动汽车PCB的需求，根据Prismark数据，2024年汽车PCB市场增长1.7%，2023-2028F年平均复合增长率为4.7%。



来源：Prismark

报告期内，公司坚定不移地在汽车电子领域持续加大研发投入，致力于全方位提升相关产品的工艺技术水平。凭借在汽车电子领域所积累的雄厚技术实力与深厚行业经验，公司进一步深化与国内外知名厂商的合作开发力度。目前，公司在智能辅助驾驶、动力能源以及智能座舱等核心产品线的批量订单正在稳步推进中。未来，随着汽车电子的快速升级、业界对PCB技术的要求也在不断提升，越来越多的高端工艺被用于PCB生产制造中。面对这一趋势，公司将持续加大汽车专线的投入力度，力求在激烈的市场竞争中占据领先地位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,685,549,652.77	6,284,056,602.79	22.30	6,961,317,142.77
归属于上市公司股东的净资产	4,273,186,784.36	3,926,700,668.03	8.82	4,084,111,699.61
营业收入	4,686,630,826.09	3,273,012,827.91	43.19	3,534,688,853.21
归属于上市公司股东的净利润	331,973,153.83	-24,993,631.93	不适用	312,909,308.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,049,615.14	-43,664,946.38	不适用	273,270,603.45
经营活动产生的现金流量净额	350,728,705.70	431,380,829.09	-18.70	741,041,313.70
加权平均净资产收益率(%)	8.24	-0.63	不适用	7.88
基本每股收益(元/股)	0.40	-0.03	不适用	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.40	-0.03	不适用	0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	6.05	5.89	增加0.16个百分点	5.53

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	884,612,737.75	1,088,547,210.02	1,206,177,057.39	1,507,293,820.93
归属于上市公司股东的净利润	26,448,680.58	69,640,051.94	90,434,867.47	145,449,553.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,269,036.69	66,279,852.82	87,035,747.55	149,464,978.08
经营活动产生的现金流量净额	45,710,924.42	153,150,602.76	131,875,831.98	19,991,346.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,595
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,565
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东生益科技股份有限公司	0	523,482,175	62.93	0	无	0	境内非国有法人
东莞市国弘投资有限公司	74,578	66,442,666	7.99	0	无	0	国有法人
广东省广新控股集团有限公司	0	13,170,860	1.58	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,342,480	10,697,363	1.29	0	无	0	未知
新余腾益投资管理中心(有限合伙)	-3,055,900	9,177,100	1.10	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金	8,438,918	8,438,918	1.01	0	无	0	其他
东莞科技创新金融集团有限公司	0	8,404,110	1.01	0	无	0	国有法人
新余超益投资管理中心(有限合伙)	-2,760,400	8,292,000	1.00	0	无	0	境内非国有法人
新余联益投资管理中心(有限合伙)	-2,699,600	8,107,600	0.97	0	无	0	境内非国有法人
新余益信投资管理中心(有限合伙)	-2,528,600	7,593,700	0.91	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明：

1. 东莞市国弘投资有限公司与东莞科技创新金融集团有限公司属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人。
2. 东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司直接持有广东生益科技股份有限公司的股份，持股比例均不足30%。东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、广东生益科技股份有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。
3. 东莞科技创新金融集团有限公司，间接持有广东生益科技股份有限公司的股份，持股比例不足30%。东莞科技创新金融集团有限公司与广东生益科技股份有限公司独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。
4. 除此之外，公司前十名股东中，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

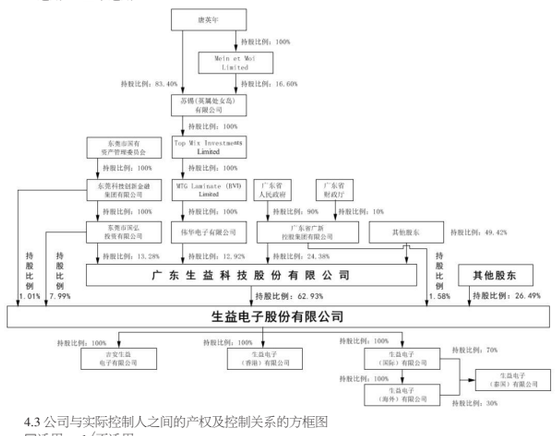
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入为468,663.08万元，与上年同期相比增加43.19%。归属于上市公司股东的净利润33,197.32万元，实现扭亏为盈。

报告期内，公司持续优化产品结构，积极完善产品业务区域布局，随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司营业收入与上年同期相比实现较大增长，叠加公司持续施行降本增效等措施，公司实现净利润扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688183　　证券简称：生益电子　　公告编号：2025-010

生益电子股份有限公司 会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

● 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，同意公司自发布年度2024年1月1日起执行。

一、概述

(一)会计政策变更原因

2024年12月，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则解释第18号》(财会【2024】24号)(以下简称“准则解释第18号”)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更的日期

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次执行“准则解释第18号”对公司的影响

根据《企业会计准则解释第18号》的要求，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，分别调增2023年度合并及母公司利润表营业成本8,843,907.80元、7,209,395.21元，调减销售费用8,843,907.80元、7,209,395.21元。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：688183　　证券简称：生益电子　　公告编号：2025-017

生益电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月21日　14点00分

召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月21日

至2025年4月21日

投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度财务决算报告	√
2	2024年度利润分配预案	√
3	2024年年度报告及摘要	√
4	2024年度董事会工作报告	√
5.00	2024年度独立董事述职报告	√
5.01	2024年度汪林独立董事述职报告	√
5.02	2024年度陈文浩独立董事述职报告	√
5.03	2024年度唐艳玲独立董事述职报告	√
6	2024年度监事会工作报告	√
7	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并议定审计费用的议案	√
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	√
9	关于变更募集资金投资项目的议案	√
10	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	√
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《生益电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2025年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688183	生益电子	2025/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：

(1)法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：

地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

邮政编码：523000

公司电话：0769-89281988，公司邮箱：bo@sye.com.cn

联系人：杭小姐

六、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。